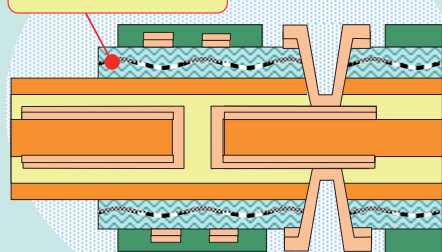


◆多層FPC4層で0.18mmの薄型化とBVH(フィルドビア)構造により、高密度化を実現

層構成例：4層ビルドアップ

第一世代RF(従来構造)

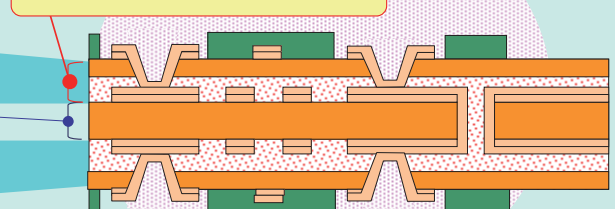
ガラスクロス



プリプレグ
カバーレイ
フレキ

薄型多層FPC(0.18mm)

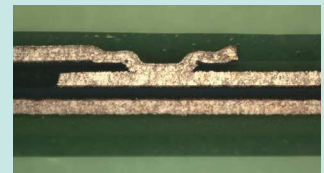
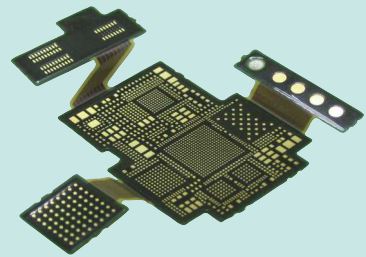
RCC(ガラスクロスレス)



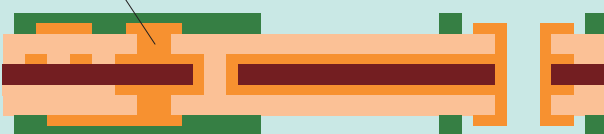
リジッド・フレックス配線板の薄型化技術を多層FPCへ展開

特徴

- ・新規フレキシブル絶縁材料の採用
- ・薄型化：4層板 0.18mm
- ・高密度化：BVHフィルドビア構造
スキップビア構造も可能
- ・環境対応：全層ハロゲンフリー 対応
- ・耐久性：ケーブル部MIT試験R0.38×50回以上
- ・配線部の特性インピーダンス整合をTDRシミュレーションで事前検討から実装までサポート
- ・部品調達を含め実装まで対応可能



BVHフィルドビア



BVHスキップビア

設計仕様(抜粋)

	設計値(um)	特記事項
L/S	75/100	個別対応 50/75um可 (CSP引き出し部)
IVH:H/L	φ150/400	
BVH:H/L	φ100/250	
TH:H/外L/内L	φ200/450/500	

